



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20111201000A

2012 年 1 月 13 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL VSSOP (DCU/DDU) /SOT (DRL) パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加取消のご案内

(初版 PCN20111201000 2011 年 12 月 5 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、**変更取消**についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたしますお客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 HVAL VSSOP (DCU/DDU) /SOT (DRL) パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行 : HANA 社(アユタヤ, タイ) 変更後 : HANA 社(アユタヤ, タイ), HANA 社(バンコク, タイ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 今回のお知らせは、2011年12月5日発行 初版 PCN20111201000にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。

弊社 HVAL (ハイボリュームアナログロジック) VSSOP (DCU/DDU) /SOT (DRL) パッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 HANA社(アユタヤ, タイ)サイトにて製造していますが、HANA社(アユタヤ, タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為に、これに加えて、HANA社(バンコク, タイ)サイトを追加します。組立部材の変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

組立検査サイト

現行

HANA社(アユタヤ, タイ)

変更後

HANA社(アユタヤ, タイ)

HANA社(バンコク, タイ)

理由 : HANA 社(アユタヤ, タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
74AUC2G125DCURE4	LPV358DDURE4	SN74LVC1G123DCUT	SN74LVC2G74DCUTG4	TPD2E001DRLR
74AUC2G125DCURG4	LPV358DDURG4	SN74LVC1G125DRLR	SN74LVC2G86DCUR	TPD2E001DRLRG4
74AVCH2T45DCURE4	LPV358IDDUR	SN74LVC1G17DRLR	SN74LVC2G86DCURE4	TPD3E001DRLR
74AVCH2T45DCURG4	LPV358IDDURE4	SN74LVC1G17DRLRG4	SN74LVC2G86DCURG4	TPD3E001DRLRG4
74CB3Q3306ADCURE4	LPV358IDDURG4	SN74LVC1G32DRLR	SN74LVC2G86DCUT	TPD4E002DRL2
74CB3Q3306ADCURG4	PCA9306DCUR	SN74LVC1G32DRLRG4	SN74LVC2G86DCUTE4	TPD4E002DRLR
74CB3T3306DCURE4	PCA9306DCURE4	SN74LVC1G98DRLR	SN74LVC2G86DCUTG4	TPD4E002DRLRG4
74CB3T3306DCURG4	PCA9306DCURG4	SN74LVC1G98DRLRG4	SN74LVC2T45DCUR	TS5A2053DCUR
74LVC1G123DCURE4	PCA9306DCUT	SN74LVC2G02DCUR	SN74LVC2T45DCURE4	TS5A2053DCURE4
74LVC1G123DCURG4	PCA9306DCUTE4	SN74LVC2G02DCURE4	SN74LVC2T45DCURG4	TS5A2053DCURG4
74LVC1G123DCUTE4	PCA9306DCUTG4	SN74LVC2G08DCUR	SN74LVC2T45DCUT	TS5A2066DCUR
74LVC1G123DCUTG4	SN74AUC1G74DCUR	SN74LVC2G08DCURE4	SN74LVC2T45DCUTE4	TS5A2066DCURE4
74LVC1G125DRLRG4	SN74AUC1G74DCURE4	SN74LVC2G08DCURG4	SN74LVC2T45DCUTG4	TS5A2066DCURG4
74LVC2G125DCURE4	SN74AUC1G74DCURG4	SN74LVC2G125DCUR	SN74LVC3G04DCUR	TS5A21366DCUR
74LVC2G125DCURG4	SN74AUC2G125DCUR	SN74LVC2G125DCUT	SN74LVC3G04DCURE4	TS5A23166DCUR
74LVC2G125DCUTE4	SN74AUC2G53DCUR	SN74LVC2G126DCUR	SN74LVC3G04DCURG4	TS5A23166DCURE4
74LVC2G125DCUTG4	SN74AUC2G53DCURE4	SN74LVC2G132DCUR	SN74LVC3G06DCUR	TS5A23166DCURG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

74LVC2G126DCURE4	SN74AUC2G53DCURG4	SN74LVC2G157DCUR	SN74LVC3G06DCURE4	TS5A23167DCUR
74LVC2G126DCURG4	SN74AUC2G66DCUR	SN74LVC2G240DCUR	SN74LVC3G06DCURG4	TS5A23167DCURE4
74LVC2G132DCURE4	SN74AUC2G66DCURE4	SN74LVC2G32DCUR	SN74LVC3G07DCUR	TS5A23167DCURG4
74LVC2G132DCURG4	SN74AUC2G66DCURG4	SN74LVC2G32DCURE4	SN74LVC3G07DCURE4	TS5A3357DCUR
74LVC2G157DCURE4	SN74AUC2G86DCUR	SN74LVC2G32DCURG4	SN74LVC3G07DCURG4	TS5A3357DCURE4
74LVC2G157DCURG4	SN74AUC2G86DCURE4	SN74LVC2G38DCUR	SN74LVC3G14DCUR	TS5A3357DCURG4
74LVC2G240DCURE4	SN74AUC2G86DCURG4	SN74LVC2G38DCURE4	SN74LVC3G14DCURE4	TS5A3359DCUR
74LVC2G240DCURG4	SN74AUP1G74DCUR	SN74LVC2G38DCURG4	SN74LVC3G14DCURG4	TS5A3359DCURE4
HPA00850DCUR	SN74AUP1G74DCURG4	SN74LVC2G53DCUR	SN74LVC3G17DCUR	TS5A3359DCURG4
LMV3581DDUR	SN74AUP2G126DCUR	SN74LVC2G53DCURE4	SN74LVC3G17DCURE4	TXB0102DCUR
LMV3581DDURE4	SN74AVC2T45DCUR	SN74LVC2G53DCURG4	SN74LVC3G17DCURG4	TXB0102DCURG4
LMV3581DDURG4	SN74AVC2T45DCURE4	SN74LVC2G66DCUR	SN74LVC3G34DCUR	TXS0102DCUR
LMV358QDDUR	SN74AVC2T45DCURG4	SN74LVC2G66DCURE4	SN74LVC3G34DCURE4	TXS0102DCURG4
LMV358QDDURE4	SN74AVCH2T45DCUR	SN74LVC2G66DCURG4	SN74LVC3G34DCURG4	TXS0102DCURLI
LMV358QDDURG4	SN74CB3Q3306ADCUR	SN74LVC2G74DCUR	TCA9406DCUR	TXS0102DCUT
LMV3931DDUR	SN74CB3T3306DCUR	SN74LVC2G74DCURE4	TLV3411DRLR	TXS0102DCUTG4
LMV3931DDURE4	SN74LVC1G08DRLR	SN74LVC2G74DCURG4	TLV3411DRLRG4	
LMV3931DDURG4	SN74LVC1G08DRLRG4	SN74LVC2G74DCUT	TLV72561DDUR	
LPV358DDUR	SN74LVC1G123DCUR	SN74LVC2G74DCUTE4	TLV72561DDURG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)が下記のようになります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	Hana-Ayutthaya	ASO: HNT
追加認定	Hana-Bangkok	ASO: HBK



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LPV3581DDUR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	VSSOP/DDU/8	
Mount Compound:	400154	Mold Compound:	450207	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	Test MQ	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TXB0102DCUR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	VSSOP/DDU/8	
Mount Compound:	400154	Mold Compound:	450207	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	Test MQ	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
X-Ray	Top side only	5	5	5
Notes: ** Preconditioning Sequence included: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LVC1G32DRLR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	SOT/DRL/5	
Mount Compound:	400173	Mold Compound:	450214	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
Manufacturability	Test MQ	per spec		
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12		

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TXS0101DRLR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	SOT/DRL/6	
Mount Compound:	400173	Mold Compound:	450214	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Solderability	Steam age, 8 hours	22	22	22
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5	5	5
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	Test MQ	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
X-Ray	Top side only	5	5	5
Notes: ** Preconditioning Sequence included: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CLVC2G125DCUR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Mount Compound:	400154	Mold Compound:	450207	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Gauge R & R	Per MFG spec	per spec	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	Test MQ	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Yield Evaluation	per mfg. Site specification	Per spec	-	-

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 1 月	終了	2012 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LVC2G74DCUR	-	-	
Assembly Site:	HBK	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Mount Compound:	400154	Mold Compound:	450207	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Leadframe Finish:	NiPdAu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Solderability	Steam age, 8 hours	22	22	22
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	5	5
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	5	5
Flammability	Method C - UL1694	5	5	5
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5	5	5
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	Test MQ	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Yield Evaluation	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Salt Atmosphere	24 hrs	22	22	22
X-Ray	Top side only	5	5	5
Gauge R & R	Per MFG spec	per spec	-	-

Notes: ** Preconditioning Sequence included: JEDEC L-1/260C